

<報道資料>

※本資料は、7月19日(現地時間)に発表された英語版プレスリリースの抄訳です。

2018年7月20日

**ウエスタンデジタル、1.33 テラビットの
4ビットセル 96層 3D NAND のサンプル出荷を開始**

テクノロジーリーダーとしての地位を強化する、
世界最高密度のモノリシック 3D NAND チップ

ウエスタンデジタルコーポレーション (NASDAQ:WDC、以下ウエスタンデジタル) は本日、3D NAND の第 2 世代となる 4 ビットセルアーキテクチャーの開発に成功したことを発表しました。QLC テクノロジーをウエスタンデジタルの 96 層 BiCS4 デバイスに導入することで、単一のチップに 3D NAND としては業界最大の 1.33 テラビット (Tb) を格納できるようになります。BiCS4 は、四日市市にある東芝メモリ社と共同で運営するジョイントベンチャーのフラッシュ生産工場が開発されました。現在サンプル出荷中ですが、本年中に量産を開始する予定です。当初はサンディスクブランドにて一般消費者向け製品を販売していきます。その後、リテールからエンタープライズ SSD まで、幅広い用途において BiCS4 の適用を予定しています。

ウエスタンデジタルの技術および生産を統括するエグゼクティブバイスプレジデント、シバ・シバラムは、次のように述べています。「ウエスタンデジタルのプロセス技術、デバイス技術、およびシステムインテグレーションの能力を活用することによって、QLC テクノロジーは 16 の異なるレベルを検知し、データ保存できるようになりました。BiCS4 QLC は当社の第 2 世代の 4 ビットセルデバイスであり、64 層 BiCS3 に QLC を実装してきた経験を生かしています。BiCS4 は、あらゆる NAND 製品のうちで最も優れたコスト構造を真に備えており、当社がフラッシュのイノベーション開発に長けていることを実証するものです。BiCS4 により、リテール環境、モバイル組み込み環境、クライアント環境、エンタープライズ環境にわたり、お客様のデータの増大に対応していきます。当社では、この 4 ビットセルテクノロジーがあらゆる用途で主流になるものと考えています」

■ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタルは、データ社会が発展する環境を創造し、かつてない多様化を遂げるデータの保存、保護、アクセス、変換に必要なイノベーションを推進していきます。先進的なデータセンターからモバイルセンサー、パーソナルデバイスまで、データが存在するあらゆる場所において、業界をリードするウエスタンデジタルのソリューションはデータの可能性を広げます。ウエスタンデジタルのデータ・セントリック・ソリューションは、G-Technology、HGST、サンディスク、Tegile、Upthere および WD のブランドで提供します。財務情報や投資家向け情報は、当社 Investor Relations サイト (investor.wdc.com) をご覧ください。

■Forward-looking Statement

This news release contains certain forward-looking statements, including statements concerning the expected availability, benefits, features, pricing and performance of Western Digital's 1.33 terabit, four-bits-per-cell, 96-layer 3D NAND device. There are a number of risks and uncertainties that may cause these forward-looking statements to be inaccurate including, among others: volatility in global economic conditions; business conditions and growth in the storage ecosystem; impact of competitive products and pricing; market acceptance and cost of commodity materials and specialized product components; actions by competitors; unexpected advances in competing technologies; our development and introduction of products based on new technologies and expansion into new data storage markets; risks associated with acquisitions, mergers and joint ventures; difficulties or delays in manufacturing; and other risks and uncertainties listed in the company's filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"),

including the company's Form 10-Q filed with the SEC on May 8, 2018, to which your attention is directed. You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and the company undertakes no obligation to update these forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances.

© 2018 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.
Western Digital、Western Digitalロゴ、SanDiskは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporation、またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商標も特定の目的のためのみに使用されるものであり、各権利者によって商標登録されている可能性があります。

<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ>

ウエスタンデジタル広報担当: 羽田野

TEL: 090-5765-9730

クレアブ株式会社

ウエスタンデジタル広報担当: 友廣、恵木、宮津

TEL: 03-5404-0640 FAX: 03-5404-7120

E-mail: WDCJapan@kreab.com